

青海玉树州 迈 芯维COB显示屏完全倒装 演播中心显示屏报告大厅 显示大屏

产品名称	青海玉树州 迈 芯维COB显示屏完全倒装 演播中心显示屏报告大厅 显示大屏
公司名称	深圳市康普信息技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301号银星科技大厦A1104、A1104-1、A1104-2、A1104-3
联系电话	0755-21038002 18565839923

产品详情

系统工作过程中的温度均匀性。越是间距更小的SMD封装小间距产品，就越是要采用高功率小颗粒LED晶体。同时，灯珠与显示板之间的缝隙则导致晶片工作过程中热传导能力障碍。COB封装由于采用更为集成化的整体工艺，使得在晶体选择上可以选用功率面积密度更低、晶体颗粒更大一些的晶片，进而降低核心发光点工作强度。同时，COB封装实现了环氧树脂全包裹下的全固体无缝隙散热，使得工作状态中LED晶体的热集中度下降，有利于延长产品寿命、提升系统稳定性。